

求人情報

企業コード:e6110 ジョブコード:20231106-233-01-002

マネージャーレベル

ポジション名	【半導体デバイス開発エンジニア】早稲田大学 研究シーズ発のスタートアップ
この求人情報の取扱い会社	株式会社 リクルート（リクルートエージェント / Recruit Agent）
企業名	(株)Power Diamond Systems
掲載開始・更新	2024-05-07 / 2024-05-08
職 種	電機（電気/電子/半導体） - プログラマー(制御系)
業 種	半導体・電気・電子部品メーカー
勤務地	アジア 日本 東京都
仕事内容	<p>世界トップクラスのデータを出しているダイヤモンド半導体デバイス開発を主導いただきます。半導体デバイス単体の開発だけでなく、パワーアンプの設計等アプリケーション側の検討もしていただきます。</p> <p>＜このポジションの魅力＞</p> <p>■早稲田大学が保有する半導体プロセス設備を最大限活用し大きな裁量権をもち、世界最先端のダイヤモンド半導体デバイスの研究開発に没頭できます。</p> <p>■22年8月創業で未だ5名に満たない人員のため、半導体研究開発の経験を活かしながら、スタートアップの創業期でしか味わえないゼロイチで事業を作り上げていく貴重な経験を積むことができます。</p>
企業について(社風など)	<p>ダイヤモンド半導体デバイスの研究開発</p> <p>従業員数 4名</p>
応募条件	<p>【必須】</p> <p>■半導体やMEMS等の微細加工プロセスを伴うデバイスの開発経験</p> <p>■英語の論文(読解)への理解</p> <p>【歓迎】</p> <p>■化合物デバイス開発経験（デバイスの設計・評価・回路設計・マスク設計等）</p> <p>■英語の論文(記述)スキル保有者</p> <p>【当社のビジョン】-究極の半導体材料ダイヤモンド"とともに一歩先の未来へ ?Diamond Opens The Future Electronics?"</p>
英語能力	ビジネス会話 (TOEIC 735-860)
日本語能力	流暢（日本語能力試験1級又はN1）
年 収	日本・円 500万円 ～ 700万円
休 日	年間休日 110日
契約期間	正社員